

Title (en)

HIGH-HARDNESS CONDUCTIVE MATERIAL AND METHOD FOR MANUFACTURING SAME.

Title (de)

LEITFÄHIGES MATERIAL MIT HOHE HÄRTE UND VERFAHREN ZUM IHREN HERSTELLUNG.

Title (fr)

MATERIAU CONDUCTEUR DE HAUTE DURETE ET PROCEDE DE FABRICATION DE CE MATERIAU.

Publication

**EP 0624206 A1 19941117 (FR)**

Application

**EP 93904133 A 19930128**

Priority

- FR 9201026 A 19920130
- FR 9300089 W 19930128

Abstract (en)

[origin: WO9315240A1] A material having superior electronic conductivity and physical and chemical stability properties. The material consists of an alloy including a first insulating and incompressible metal oxide forming the metal matrix of the material, and a second oxide of an alloying element acting as an electronic conductor. The various precipitates making up the second oxide are mutually connected to form a conductive path within said matrix. Said material may be used particularly to produce electrical contacts.

Abstract (fr)

L'invention concerne un matériau conducteur de haute dureté et son procédé de fabrication. Le but de l'invention est de réaliser un matériau présentant simultanément de bonnes propriétés de conductibilité électronique et de stabilité physique et chimique. Ce but est atteint à l'aide d'un matériau constitué d'un alliage comprenant un premier oxyde d'un métal, ce premier oxyde isolant et inaltérable formant la matrice métallique du matériau et un second oxyde d'un élément d'addition formant un conducteur électronique, les différents îlots constituant ce second oxyde étant reliés entre eux pour former un chemin conducteur à l'intérieur de ladite matrice. Ce matériau est notamment destiné à réaliser des contacts électriques.

IPC 1-7

**C23C 8/10**; H01B 1/08; C22C 1/10

IPC 8 full level

**C23C 8/10** (2006.01); **H01B 1/08** (2006.01)

CPC (source: EP)

**C23C 8/10** (2013.01); **H01B 1/08** (2013.01)

Citation (search report)

See references of WO 9315240A1

Designated contracting state (EPC)

BE CH DE FR GB LI NL SE

DOCDB simple family (publication)

**WO 9315240 A1 19930805**; DE 69300632 D1 19951116; DE 69300632 T2 19960509; EP 0624206 A1 19941117; EP 0624206 B1 19951011; FR 2686903 A1 19930806; FR 2686903 B1 19940318

DOCDB simple family (application)

**FR 9300089 W 19930128**; DE 69300632 T 19930128; EP 93904133 A 19930128; FR 9201026 A 19920130